AK-145 高导热非硅质导热膏

特　　点

- 为环氧树脂基材的导热膏，非属硅质系统，无渗油问题。
- 高热传导系数 20.0 W/mK。
- 涂抹后不会硬化，易于使用，去除方便，重工性佳。
- 符合 RoHS 2.0 规范。

用　　途

- 帮助降低发热组件温度，或是加强导热传热的应用。
- 可应用于 5G、电动汽车、晶体管、温控设备、CPU....等各类产品中。

基 本 物 性

外　　观	：		灰色膏状物
黏　　度	：	@25˚C	70,000 ~ 110,000 cps
比　　重	：		2.4 ~ 2.6 g/cm^3
工 作 温 度	：		110˚C
热 传 导 系 数	：	Hot Disk ISO22007-2.2	20.0 W/mK
绝 缘 强 度	：		10 kV/mm
体 积 电 阻	：		>10^{11} ohm-cm
热 裂 解 温 度	：		<0.5% (390˚C)
UL 阻燃等级	：	UL94	V-0 (内部测试)
包　　装	：		1KG/罐
保 存 期 限	：	@25˚C, 未开封	6 个月

注 意 事 项

- 本产品含无机填充物，膏体若发生分层现象属正常情况，须先搅拌均匀后再取用。
- 为免灰尘或杂质影响导热效果，请于上胶前先针对对象表面进行基本清洁后，再进行上胶程序。
- 涂布时，尽可能避免产生气泡，以免影响导热性能。
- 未使用完的产品请保持容器紧闭，并储存于干燥阴凉处且避免阳光直射。
- 主要清洗溶剂为丙酮。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976